

证券代码：601138

证券简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他								
参与单位名称	中银基金、慧利资产、中信里昂证券、安信证券、Jellola Investments Pte. Ltd.、东信投资、上海大朴资产、法国巴黎银行（香港）、华泰证券、中金公司、华创证券、银河证券								
时间	2026年5月20日 15:00-16:00								
地点	线上会议								
上市公司接待人员姓名	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">董事长&总经理</td> <td style="width: 50%;">郑弘孟</td> </tr> <tr> <td>财务总监</td> <td>沈道邦</td> </tr> <tr> <td>董事会秘书</td> <td>刘宗长</td> </tr> <tr> <td>证券事务代表</td> <td>揭晓小</td> </tr> </table>	董事长&总经理	郑弘孟	财务总监	沈道邦	董事会秘书	刘宗长	证券事务代表	揭晓小
董事长&总经理	郑弘孟								
财务总监	沈道邦								
董事会秘书	刘宗长								
证券事务代表	揭晓小								
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：一季度消费电子业务承压，请问董事长，在消费电子“五穷六绝”的淡季中，AI业务是否具备对冲消费电子波动的体量与增速，请展望一下后续及全年情况，谢谢。</p> <p>回复：</p> <p>首先，从消费电子情况看，上半年确实是传统淡季，但我们与大客户联合研发的新品已进入量产准备，具体表现取决于客户上市节奏与市场需求。</p> <p>第二，AI基建业务的体量与增速，已成为公司重要的成长动能之一。2026年第一季度，云计算业务同比增长1倍，AI已成为公司核心的成长引擎之一。从实际经营趋势看，AI业务的放量正在持续转化为业绩贡献。但行业需求波动、市场竞争加剧以及技术迭代等因素可能对行业发展带来不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q2：此前公司介绍了已经向客户提供CPO全光交换机的样机，想请问最新的进展怎么样，从样机到量产的推进节奏如何？后续scale out和scale up应用落地情况怎么看？</p> <p>回复：</p> <p>第一，公司正积极推进量产目标，根据客户需求情况，从Scale-out到Scale-up都会陆续导入，产品落地持续推进。</p> <p>第二，当前相关产能正在积极建制当中。凭借着过去的技术与经验，以及源自上一</p>								

	<p>代产品把握的经验，相信我们能达到一定的生产水平，但可能受到客户导入不及预期、以及供应链配套存在不确定性因素等影响，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q3：我们关注到 Groq LPU 等新兴 AI 推理芯片架构的崛起，公司如何看待这一趋势带来的机会？在机柜方案和潜在产品上有哪些布局？</p> <p>回复：</p> <p>首先，推理市场确实正在快速崛起。据 TrendForce 报告，2026 年 ASIC-based AI 服务器占比达 27.8%，为 2023 年以来最高，到 2030 年将接近 40%。全球 AI 模型 Token 使用量呈指数级增长，AI 从"生成式"向"代理式"演进，推理算力需求成为核心增量，这一行业趋势，为公司打开了新的增长空间。</p> <p>第二，公司与核心客户合作根基深厚，从当前主流平台到下一代平台始终保持紧密协同，覆盖算力模组、网络及高速互联等多个核心环节。</p> <p>第三，公司在产能筹备方面正在积极推进，按计划推进扩产，以支撑新产品的放量节奏。这意味着无论客户选择 GPU 训练集群、推理机柜或两者混合部署，公司均能提供核心环节到整柜集成的一站式交付，进一步强化在 AI Factory 基础设施中的份额与粘性。但行业技术迭代加速、客户资本开支波动及市场竞争加剧可能带来业务拓展不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q4：市场近期流传 Vera Rubin 设计变更及延期、下修其出货占比预期的传闻。公司实际出货节奏如何？竞争格局与份额确定性怎样？</p> <p>回复：</p> <p>首先，市场所提到的"设计变更"，大部分是在讨论新产品导入期的常规工程优化。根据 TrendForce 产业调查，Rubin 系列在新产品导入阶段需要供应链调校，包括 HBM4 认证、网络接口升级及液冷方案优化等。</p> <p>第二，竞争格局与份额方面，公司与多家主要客户在高端 AI 服务器 ODM 领域的制造优势与客户粘性持续巩固。但行业竞争加剧或对产品量产及份额提升带来不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	